

BiPass I/O高速解决方案



具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案，高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路

特点和优点

BiPass可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer

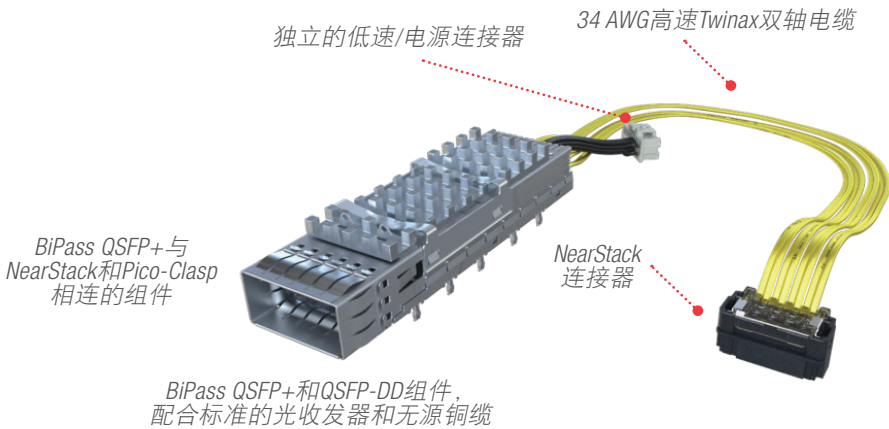
提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比，可提供更强的性能和更低的插入损耗，从而获得更大的通道余量

	FR4	Megtron 6	双轴电缆
每英寸插入损耗	1.7	0.8	0.25
4英寸插入损耗	6.7	3.2	1
8英寸插入损耗	13.3	6.3	2
12英寸插入损耗	20	9.5	3
18英寸插入损耗	30	14.2	4.5

与电路板印刷走线相比，插入损耗较低，这对PAM-4协议至关重要

与电路板印刷走线相比，可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接。无需昂贵的电路板材料和重定时器

在12.5 GHz速率下进行插入损耗分析，将FR4和Megtron 6印刷电路板与twinax双轴电缆（用在BiPass电缆组件中）进行比较



独立电缆组件已经过充分测试
确保可靠性。客户无需再进行该测试

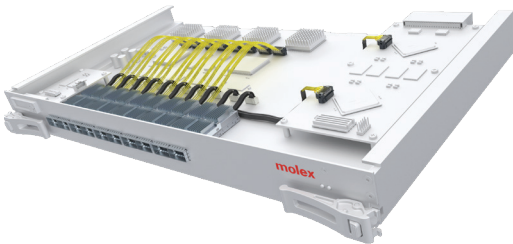
NearStack高速连接器

符合112 Gbps PAM-4协议要求
提供最先进的性能

电路数量增加：
最多可达42个差分线对
占用的电路板空间更少。
增加布局密度



图中所显示的是8-DP连接器



BiPass解决方案：装入托盘的QSFP+与NearStack和电源/信号连接器相连的组件

可提供电源至电路板的压接式连接
实现腹部对腹部的配置



BiPass 压配型QSFP+与NearStack相连的组件

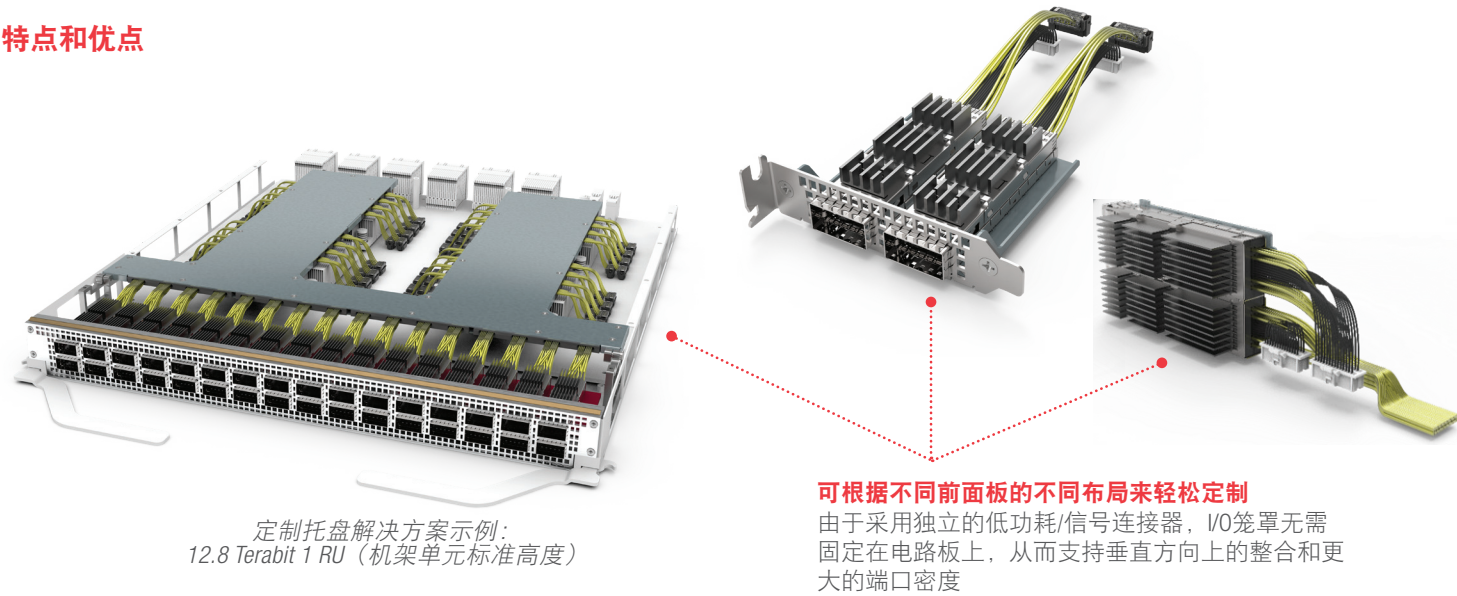


0.60毫米端子间距，紧凑地堆叠在9.00×19.00毫米网格上（密度大，每平方英寸空间容纳30.2个差分线对）
减少了电路板上的空间占用，缓解了空间紧张问题

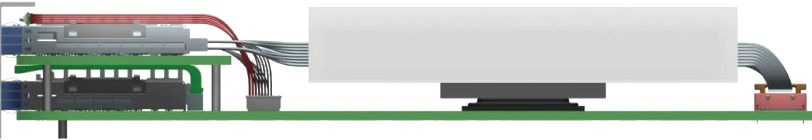
BiPass I/O高速解决方案

molex

特点和优点



Twinax双轴电缆可在布线中最大限度地减少气流阻力
改善散热性能，增加设计灵活性。
插入损耗低，因此信号完整性指标出众

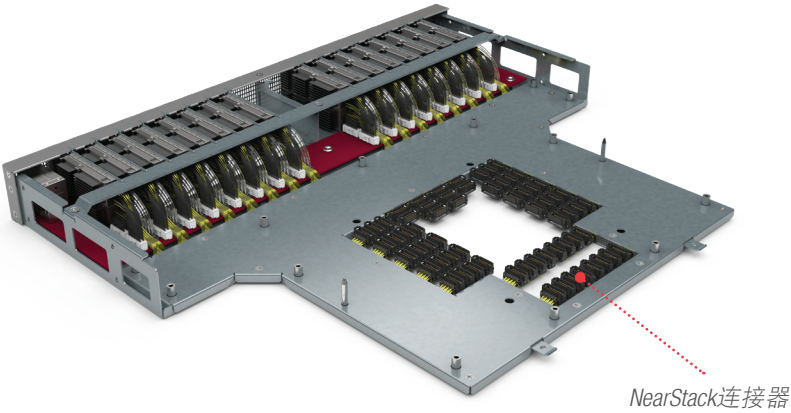


托盘组件

可提供全集成定制设计的电线管理托盘
提供全面解决方案。减少了客户的工程设计工作并简化了制造过程

应用场合

- 数据中心解决方案
- 数据中心交换机
- 数据中心服务器
- 数据中心路由器
- 电信/网络
- 架顶交换机
- 核心路由器



垂直导向托盘解决方案在板下方接近ASIC的位置进行端接

订购信息

定制产品	描述
联系Molex公司	BiPass I/O高速解决方案

www.molex.com/link/bypass.html
www.chinese.molex.com/link/bypass.html